



推奨基板取付け寸法
 PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
 コネクタ: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
 ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

A ROW		X	Y	△6 △4	3-917657-5
B ROW		X	Y	△6 △3	3-917657-3
				△6 △2	3-917657-2
A ROW		Y	Y	△6 △4	2-917657-5
B ROW		Y	Y	△6 △3	2-917657-3
				△6 △2	2-917657-2
A ROW		X	X	△6 △4	1-917657-5
B ROW		X	X	△6 △3	1-917657-3
				△6 △2	1-917657-2

KEYING LOCATION		A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号 PART NO.
TE TE Connectivity					
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME			
mm (AWG -)	mm φ	ダイナミック D-3200 垂直タイプ 10極 ヘッダーアセンブリー			
MATERIAL	FINISH	DYNAMIC D-3200 10 POS.V-HDR ASS'Y			
SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
DR. 24/APR/'95 K.IKEDA	DE. 24/APR/'95 K.IKEDA	10MF ±0.3	SIZE A3	LOC J	NUMBER C-917657
CHK. 24/APR/'95 S.MANABE	APP. 24/APR/'95 S.MANABE	100MF ±0.4	SCALE 2-1		
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	REV. B1 SHEET 1 OF 1

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST